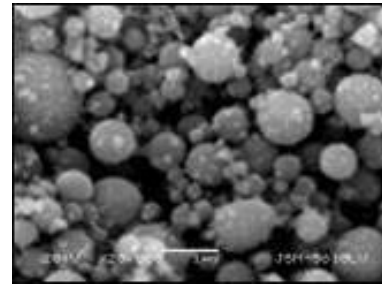


低輻射石英粉(Low 矽微粉)是封裝膠及塑料非常重要的材料，也是福納米公司之矽微粉系列中，品質最高檔產品，除純度趨近 3N 外，Low SiO₂ 的低放(輻)射線為鈾元素，保證低於 0.5 ppb，實際檢測保持在 0.1 ppb 的生產水準，遠低於商業標準 1ppb，其中 D50 粒徑約 20 μ m 低輻射(Low)球型石英矽微粉已有穩定大量出口日本實績，值見低輻射(Low) 石英矽微粉品質已達國際水準。



石英粉(或稱二氧化矽微粉、矽微粉)中的鈾含量的多少對封裝塑料而言是非常重要的，因為當石英粉中的鈾含量超標而又用來封裝記憶體或中央處理器，時會使電腦產生隨機式的「軟錯誤」。因此，商業中將鈾含量小於 1ppb 的石英粉，從矽微粉產品中獨立出來稱為低輻射(1ow)石英粉。

中低階記憶體或LED封裝可採低輻射(Low)熔融石英矽微粉，但大型或超大型積體電路(LSI & VLSI)、或中央處理器因線路集中緊密，則需使用球形低輻射(1ow)石英粉，乃因球形摩擦係數小，應力集中小，對模具磨損小，塑封塊不易損壞，並且成模流動性好，充填量高，可達90.5%，可調節塑封料接近單晶矽片的熱膨脹係數，確保超大規模積體電路的運行穩定。因此，低含鈾量的球形熔融二氧化矽微粉，是目前唯一能確保超大型積體電路(VLSI)穩定可靠工作的塑封料的最佳主料。

福納米公司供應的低輻射(low α)石英(二氧化矽)微粉有：

1. 非球型低輻射(low α) 矽微粉(LFS、Low-α Fused Silica)：粒徑 d50 4μm(LFS-040-A1)、10μm(LFS-100-A1)、20μm(LFS-200-A1) 三種規格；
2. 球型低輻射(low α) 矽微粉(LSS、Low-α Spherical Silica)：粒徑 d50 4μm(LSS-040-A1)、10μm(LSS-100-A1)、20μm(LSS-200-A1) 三種規格。
3. 除標準規格外，客戶需求有達 5 噸以上者，在生產能力範圍內可訂製特定規格。

除低輻射(low α)石英矽微粉外，福納米公司提供全系列高階二氧化矽微粉，純度 99.5%、特殊需要可 3N、透明白度高、顆粒分佈均勻且窄，金屬雜質含量低，具備耐溫性好、耐酸鹼腐蝕、高絕緣、低膨脹、化學性能穩定、硬度大等優良的性能，被廣泛用於化工、電子、積體電路(IC)、電器、塑膠、塗料、高級油漆、橡膠、國防等領域。

福納米公司係導熱材料專業服務廠商，提供「HyGood」之氮化鋁基板裸片及金屬化應用產品，亦提供高純度之氮化鋁、氮化硼、球形氧化鋁、球形石英粉導熱粉體，詳細請參考 <http://FNAMI.com.tw>，或 Email：FNAMICorp@gmail.com 洽詢。